

强于大市

电子材料行业 2026 年三季报综述

利润增速显著，看好国产替代加速推进

受下游高景气延续以及半导体材料涨价驱动，叠加产能陆续释放、国产化持续推进，我们预计材料企业收入将维持较快增长，其中先进制程及先进封装相关材料以及国产替代兑现节奏较快的品类有望延续领跑态势。维持行业*强于大市*评级。

支撑评级的要点

- **行业景气度：材料市场规模不断扩大，国产替代持续推进。**WSTS 预计 2026 年全球半导体市场规模达 1.655 万亿美元（同比+108%）、2027 年约 2.14 万亿美元（同比+29%）；SIA 数据显示 26Q3 全球半导体销售额 5,177 亿美元（环比+24.1%）。SEMI 预计 2026/2027 年全球半导体材料市场规模 830/920 亿美元（同比+12.8%/+11.4%），连续两年双位数增长。2026 年以来因需求高增、成本上升及地缘冲突三重共振，全球半导体材料掀起涨价浪潮；另一方面，我国电子材料国产替代持续推进。
- **电子材料行业 2026 年前三季度业绩综述：1）营业总收入：行业收入普遍增长。**根据我们建立的电子材料行业 69 家标的库（详见正文图表 10），2026 年前三季度营收 1,224.02 亿元（同比+26.94%），同比增长 63 家、占比 91.3%，其中增速超 30%的 27 家、超 50%的 9 家；26Q3 营收 440.80 亿元（同比+24.31%、环比+5.03%）。**2）归母净利润/扣非归母净利润：26Q3 利润端大幅提升，部分利润受非经常性项目抬升。**2026 年前三季度归母净利润 124.37 亿元（同比+48.96%）、扣非归母净利润 90.34 亿元（同比+34.10%）；26Q3 归母净利润 59.28 亿元（同比+90.89%）、扣非归母净利润 39.92 亿元（同比+82.27%）。**3）毛利率与净利率：26Q3 同环比均提升。**2026 年前三季度毛利率 25.63%（同比-0.23pct）、净利率 10.24%（同比+1.43pct）；26Q3 毛利率 26.63%（同比+0.42pct、环比+1.00pct）、净利率 13.47%（同比+4.37pct）。**4）研发费用：投入持续增加，费用率受收入摊薄。**2026 年前三季度研发费用 74.81 亿元（同比+21.93%），研发费用率 6.11%（同比-0.25pct），安集科技（15.54%）、鼎龙股份（15.22%）、沪硅产业（10.84%）研发费用率居前。**5）资本开支：扩张节奏放缓，硅片龙头投入强度较大。**2026 年前三季度资本开支 226.42 亿元（同比+12.82%），占营业收入比重由 2025 年前三季度的 20.81%降至 18.50%；沪硅产业、西安奕材两家占全行业 26.44%。**6）市值 300 亿元以上标的：利润增速显著。**2026 年前三季度 13 家龙头企业营收 465.09 亿元（同比+27.05%，增速较全行业高 0.11pct）、归母净利润 60.87 亿元(同比+105.11%，增速较全行业高 56.15pct)、扣非归母净利润 33.84 亿元(同比+47.55%，增速较全行业高 13.46pct），分别占全行业的 38.00%、48.94%、37.46%。
- **电子材料行业 26Q4 及未来展望：需求端：AI 与存储高景气有望延续，先进技术迭代促进材料需求持续扩大。**全球半导体市场有望继续维持高增速，对晶圆制造材料与封装材料的消耗量有望持续提升。中长期来看，先进技术迭代促进材料需求持续扩大，先进制程与先进封装共同推动材料用量与品类扩容。**价格端：部分材料进入涨价周期，盈利弹性有望逐渐释放。**本轮半导体材料涨价已覆盖硅片、电子特气、靶材、湿电子化学品等多个核心品类，我们预计材料涨价带来的相关效益有望在 2026 年下半年及以后逐渐体现。**市占率：材料国产化加速推进，平台化、国际化布局持续深化。**本轮下游高景气叠加部分海外供应波动，我国半导体材料行业或迎来国产替代加速的关键窗口期。例如钨、镓、锗、高纯铪相关两用物项出口管制细则落地执行，倒逼海外晶圆厂主动加大国产靶材导入比例。此外，电子材料企业向平台化产业链配套转型，并持续深化国际化布局。例如鼎龙股份抛光垫、抛光液、清洗液及高端晶圆光刻胶协同发展，并拓展大硅片、SiC、先进封装用 TSV 等新应用场景；安集科技围绕化学机械抛光液、功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂三大产品平台及上游关键原材料持续布局，提升一站式服务能力；雅克科技覆盖半导体前驱体、光刻胶及配套试剂、电子粉体材料、特种气体等，已构建中韩双研发部门，韩国子公司 UP CHEM 第三工厂预计 2026 年底全面投产、第四工厂已启动规划。**除内生研发外，外延并购亦成为企业快速切入的路径。**例如翰博高新通过收购东进世美肯（上海）资产，直接快速获取湿电子化学品行业的成熟技术、规模化产能、稳定客户资源及本土化布局优势；聚和材料完成对 SK Enpulse 空白掩膜版业务的收购，该事业部产品已通过多家半导体晶圆厂自有产线配套验证及第三方独立掩膜版客户验证并实现量产销售。

投资建议

- **基于下游行业快速发展、先进技术不断迭代以及国产替代大背景，我们认为电子材料领域有望持续迎来发展良机。**

  1、受益于下游需求增长以及技术不断进步，全球半导体材料市场规模持续扩大，先进材料需求快速提升。在多种关键半导体材料方面，我国企业稳健布局产能与技术研发，竞争力与产销规模有望持续提升。

  2、部分半导体材料及原料受益于涨价，下游高景气叠加海外龙头扩产速度较慢、受到原材料供应波动等影响，我国半导体材料行业或迎来国产替代加速的关键窗口期。

  推荐：**安集科技、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技、彤程新材、沪硅产业、德邦科技、莱特光电、瑞联新材**；建议关注：**国瓷材料、华特气体、联瑞新材、中船特气、中巨芯、西安奕材、广钢气体、昊华科技、翰博高新**等。

评级面临的主要风险

- 技术升级迭代的风险，下游需求复苏不及预期的风险，全球经济周期性波动、国际贸易摩擦及不可抗力的风险。

相关研究报告

《化工行业周报 20261115》20261116
《化工行业 2026 年三季报综述》20261111
《化工行业周报 20261108》20261109

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格

基础化工

证券分析师：余嫄嫄
(8621)20328550
yuanyuan.yu@bocichina.com
证券投资咨询业务证书编号：S1300517050002

证券分析师：范琦岩
qiyan.fan@bocichina.com
证券投资咨询业务证书编号：S1300525040001

目录

2026 年以来板块走势：电子材料相关指数冲高后回落 4

行业景气度：材料市场规模不断扩大，国产替代持续推进 5

全球半导体市场：26Q3 销售额环比增长 24.1% 5
半导体材料：SEMI 预计 2026/2027 年连续双位数增长 7
多种半导体材料进入涨价周期 7
电子材料国产替代持续推进 8

电子材料行业 2026 年前三季度业绩综述 13

营业总收入：行业收入普遍增长 13
归母净利润/扣非归母净利润：26Q3 利润端大幅提升，部分利润受非经常性项目抬升 14
毛利率与净利率：26Q3 同环比均提升 14
研发费用：投入持续增加，费用率受收入摊薄 15
资本开支：扩张节奏放缓，硅片龙头投入强度较大 16
市值 300 亿元以上标的：利润增速显著 16

电子材料行业 26Q4 及未来展望 18

投资建议 19

风险提示 20

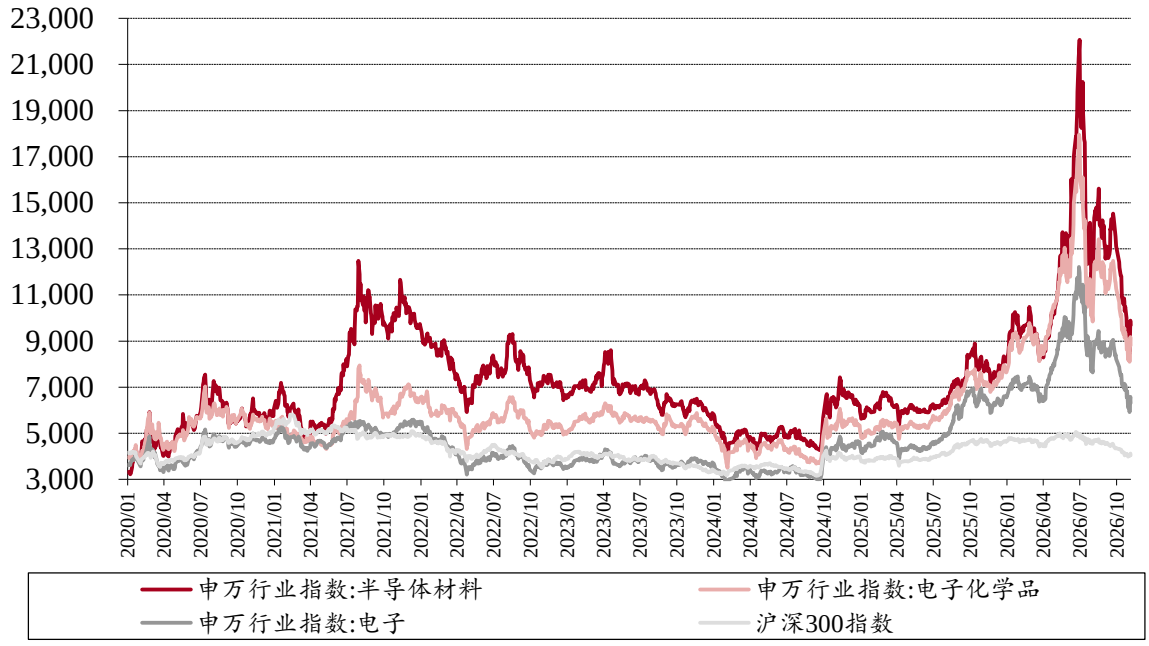
图表目录

图表 1. 2020.1.1-2026.11.6 申万半导体材料指数、申万电子化学品指数与沪深 300 指数 4
图表 2. 2020-2029E 全球半导体市场规模 5
图表 3. 2023-2026Q2 全球半导体分季度营收 6
图表 4. 2006.9-2026.9 全球半导体营收 6
图表 5. 2021-2025 年全球半导体材料市场销售额 7
图表 6. 2025 年全球分地区半导体材料市场销售额 7
图表 7. 部分关键半导体材料涨价情况梳理 8
图表 8. 国内部分企业部分晶圆制造材料业务进展（截至 2026 年中报） 9
续 图表 8. 国内部分企业部分晶圆制造材料业务进展（截至 2026 年中报） 10
续 图表 8. 国内部分企业部分晶圆制造材料业务进展（截至 2026 年中报） 11
图表 9. 国内部分企业先进封装材料项目进展（截至 2026 年中报） 12
图表 10. 2022-2026 年前三季度电子材料行业营业总收入及同比 13
图表 11. 2022-2026 年前三季度电子材料行业归母净利润、扣非归母净利润及同比 14
图表 12. 2022-2026 年前三季度电子材料行业毛利率、净利率 15
图表 13. 2022-2026 年前三季度电子材料行业研发费用及同比 15
图表 14. 2022-2026 年前三季度电子材料行业研发费用率 15
图表 15. 2022-2026 年前三季度电子材料行业资本开支及同比 16
图表 16. 2022-2026 年前三季度电子材料行业资本开支/营业总收入 16
图表 17. 市值 300 亿元以上部分标的 2026 年前三季度业绩（总市值截至 2026.11.6） 17

2026 年以来板块走势：电子材料相关指数冲高后回落

26H1 电子材料相关指数大幅上涨，此后连续回落。根据万得数据，截至 2026 年 6 月 30 日，申万半导体材料指数年内上涨 165.82%，申万电子化学品III指数上涨 134.75%，同期申万电子指数上涨 86.29%、沪深 300 上涨 7.55%。6 月末至 7 月初，两大电子材料指数冲高后连续回落。截至 11 月 6 日，申万半导体材料指数年内收益收窄至+19.50%，电子化学品III为+15.33%；同期申万电子为-3.61%、沪深 300 为-12.43%。电子材料板块年内仍跑赢沪深 300 与申万电子，但相对收益较 6 月末明显收窄。

图表 1. 2020.1.1-2026.11.6 申万半导体材料指数、申万电子化学品指数与沪深 300 指数



资料来源：万得，中银证券

行业景气度：材料市场规模不断扩大，国产替代持续推进

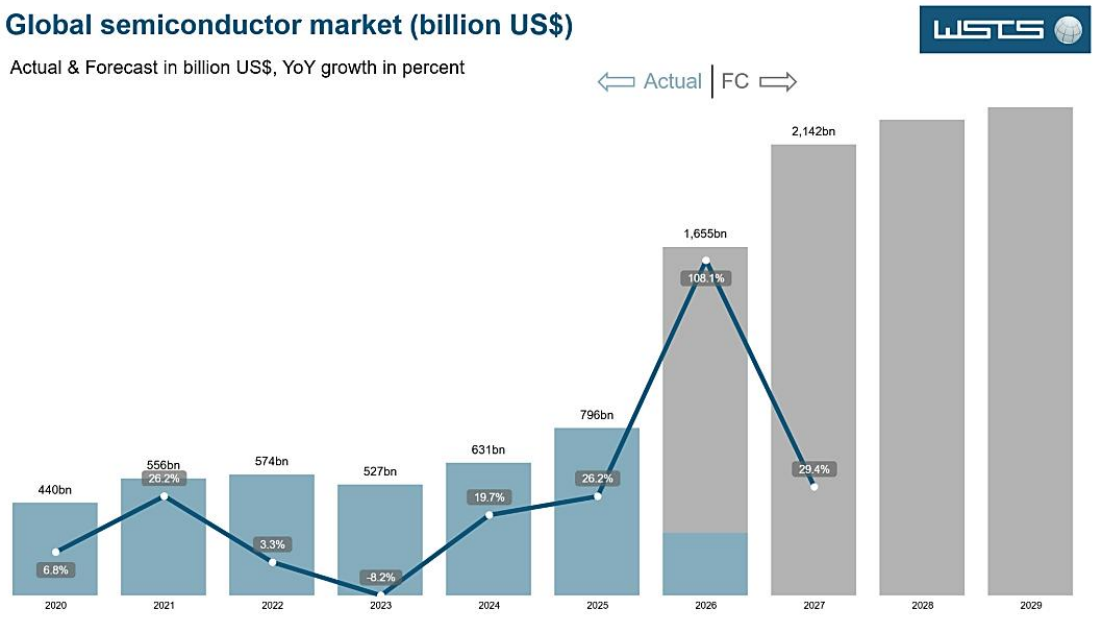
全球半导体市场：26Q3 销售额环比增长 24.1%

全球半导体市场高速增长。全球半导体贸易统计组织（WSTS）公布 26Q2 统计数据，预计 2026 年全球半导体市场规模将达到 1.655 万亿美元，同比增长 108%，较春季预测增速 89.9%进一步上调。数据显示，26H1 全球半导体市场规模达 7,020 亿美元，同比增长 102%，其中 26Q2 半导体营收达 4,030 亿美元，同比增长 124%。从产品类别来看，26H1 存储器市场营收同比增长 305%，预计全年增长 302%，高于此前预测的 249%；逻辑芯片营收同比增长 45%。WSTS 预计 2027 年全球半导体市场规模将达约 2.14 万亿美元，同比增长约 29%。

半导体行业协会（SIA）于 2026 年 11 月 3 日公布的数据显示，26Q3 全球半导体销售额 5,177 亿美元，环比增长 24.1%，连续第三个季度环比增速超 20%；其中 9 月销售额 1,726 亿美元，同比增长 146.8%、环比增长 7.9%。分地区看，9 月美洲销售额同比+191.7%，亚太/其他地区+141.4%，中国+124.9%，欧洲+102.5%，日本+73.4%。

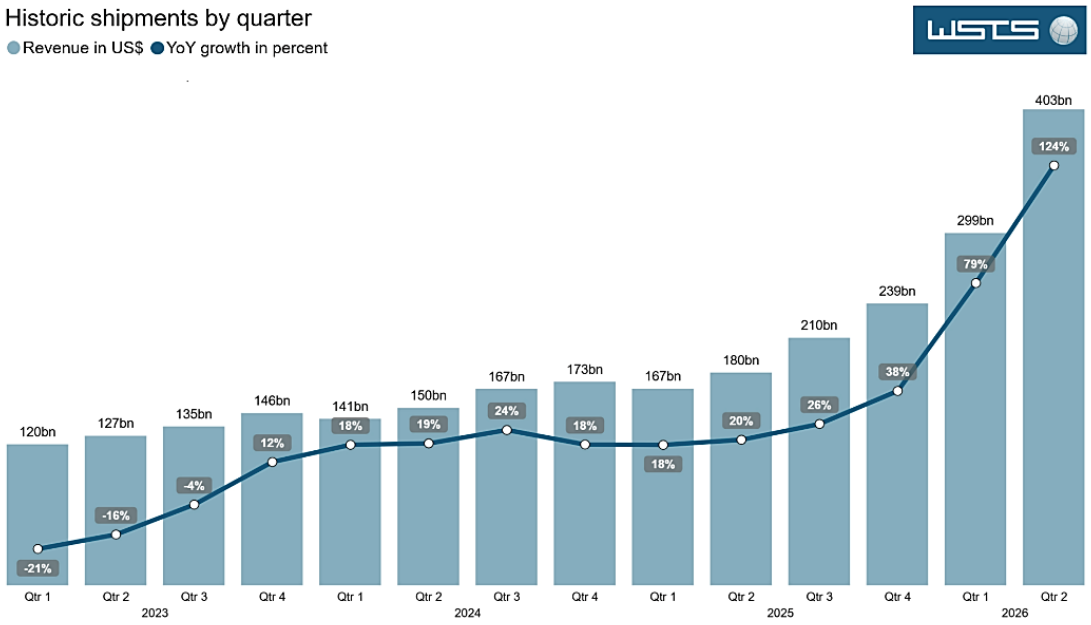
根据雅克科技 2026 年中报，中国半导体市场在政策支持和国产替代推动下，预计 2026 年市场规模 8,120.8 亿美元，较 2025 年的 4,210 亿美元同比增长 92.9%，显示出强劲增长趋势。

图表 2. 2020-2029E 全球半导体市场规模



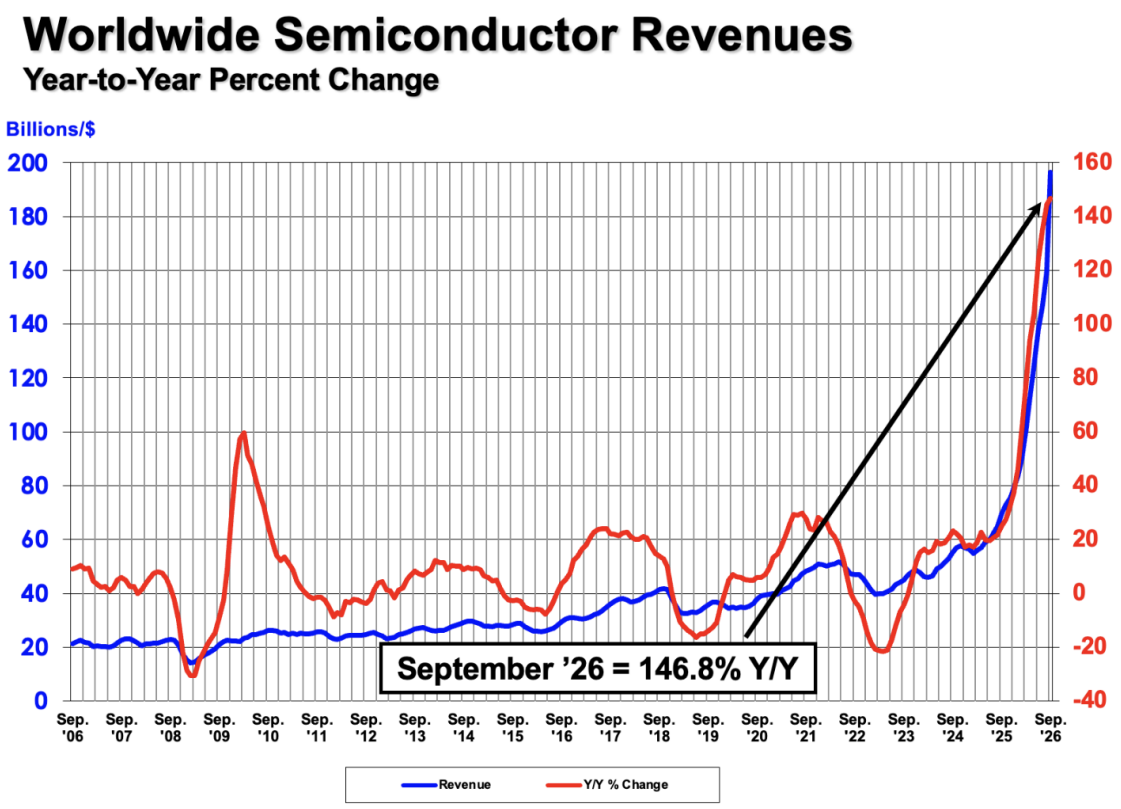
资料来源：WSTS，中银证券

图表 3. 2023-2026Q2 全球半导体分季度营收



资料来源：WSTS，中银证券

图表 4. 2006.9-2026.9 全球半导体营收



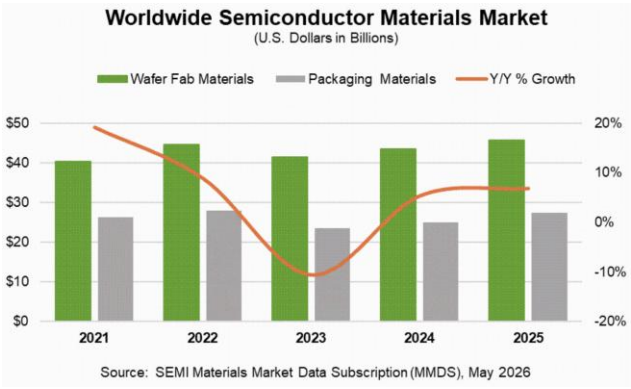
资料来源：WSTS，SIA，中银证券

半导体材料：SEMI 预计 2026/2027 年连续双位数增长

半导体材料市场规模续创新高，SEMI 预计 2026/2027 年连续双位数增长。根据 SEMI、安集科技 2026 年中报以及灼识咨询报告，全球半导体材料市场规模持续扩容，2025 年全球半导体材料市场销售额为 732 亿美元，同比增长 6.8%，其中晶圆制造材料 458 亿美元（+5.4%）、封装材料 274 亿美元（+9.3%）。分地区看，中国台湾地区以 217 亿美元连续第 16 年位居全球最大半导体材料消费地区，中国大陆 156 亿美元排名第二，韩国 112 亿美元排名第三；除欧洲外，所有地区均实现同比增长，中国大陆和北美增长最强。根据芯机甲公众号，SEMI 在 2026 年 9 月预计，2026/2027 年全球半导体材料市场规模分别为 830/920 亿美元，同比分别+12.8%/+11.4%，连续两年双位数增长。

我们认为，受益于半导体产业长期发展趋势，全球半导体材料市场规模有望保持增长态势，随着逻辑、存储器件向先进节点演进，以及三维集成和先进封装需求的快速增长，晶圆制造材料和封装材料需求有望持续提升。

图表 5. 2021-2025 年全球半导体材料市场销售额



资料来源：SEMI，中银证券

图表 6. 2025 年全球分地区半导体材料市场销售额

Semiconductor Materials Market Revenue by Region

(U.S. Dollars in Billions)

Region	2025	YoY % Growth
North America	$6.2	10.7%
Europe	$4.2	-6.0%
Japan	$6.8	2.3%
Chinese Taiwan	$21.7	8.6%
South Korea	$11.2	2.4%
Chinese Mainland	$15.6	12.5%
ROW	$7.5	6.7%
Total	**$73.2**	**6.8%**

Source: SEMI Materials Market Data Subscription (MMDS), May 2026

资料来源：SEMI，中银证券

多种半导体材料进入涨价周期

2026 年以来全球半导体材料掀起涨价浪潮（详见我们于 2026 年 8 月发布的《半导体材料涨价深度报告》），且本轮涨价范围已经由点到面从关键化工原料扩散至制造全链条，覆盖硅片、电子特气、湿电子化学品、靶材等几乎所有核心品类，形成全产业链价格上行态势。

我们认为，本轮半导体材料涨价原因包括需求高增、成本上升及地缘冲突三重共振。首先，AI 算力需求高增拉动半导体全产业链需求，全球半导体市场规模大幅增长；半导体材料需求直接受益于下游晶圆厂扩产周期，且 AI 浪潮大幅提升了上游材料消耗量。其次，中东事件对全球供应链与能源成本产生影响，能源价格波动传导至化工原料与部分电子材料制造成本，红海航道扰动推高国际物流成本。例如，位于日本的全球硅片与光刻胶龙头公司因成本等原因开启本轮涨价。此外，由于供给端硬约束+AI 需求高增，金属价格走强，算力金属集体涨价。例如，受化工品、算力金属等原材料以及生产成本上涨影响，靶材、电子级氢氟酸等产品涨价；受原材料出口管制以及海外供应扰动影响，六氟化钨、氦气等产品价格出现上涨。地缘政治或成为半导体材料定价的核心矛盾之一，我们认为本轮涨价周期区别于以往单纯需求拉动，部分材料呈现“管制触发-产能断供-价格跳涨-传导加速”的特征。

图表 7. 部分关键半导体材料涨价情况梳理

材料	涨价情况	涨价原因	境外主要生产企业	中国大陆主要生产企业	国产化率
硅片	1、2026 年 5 月信越化学、SUMCO、环球晶圆三大全球硅片龙头同步发布涨价函，开启年内第二轮提价，其中 12 英寸常规硅片涨价 5%-8%，适配 AI/HPC 场景的高端专用硅片涨幅达 18%-22%。在 12 英寸硅晶圆领域，26Q3 抛光片均价预计将达 80 美元，外延片则达 100 美元以上；8 英寸硅晶圆继 26Q2 调涨个位数百分比后，26Q3 预计维持同等涨幅。 2、6 月 12 日立昂微对客户发出产品价格调整通知函，对全系列产品进行涨价；对于旗下半导体硅片业务，立昂微旗下金瑞泓表示，鉴于上游原材料成本上涨导致成本提升，公司决定自 7 月 1 日起，对金瑞泓硅片业务价格上调 10%-15%。	需求增长、供给受限、成本上升	信越化学、SUMCO、环球晶圆、Siltronic、SK 集团等	沪硅产业、西安奕材、立昂微、TCL 中环、上海合晶、神工股份、有研硅等	12 英寸约 35%
六氟化钨	2026 年 9 月，我国出口六氟化钨 100.7 吨，环比增加 55.7 吨，增幅 124%。9 月中国六氟化钨出口总金额 1.7 亿元，出口均价 1,702 元/千克，环比增长 4%。出口均价持续增长，年初至今累计涨幅达 254%，预计后市价格或超过 2,000 元/千克。	上游钨粉原料价格走高；相关管控政策落地，加剧全球供给紧张格局	关东电化、中央硝子等	中船特气、昊华科技、中巨芯	65%+
靶材	26Q1 电子靶材企业已普遍启动提价，其中常规靶材价格涨幅达 20%，特殊小金属类靶材涨幅达 60%-70%。	AI 算力需求高增、原材料价格波动与地缘政治共振推动靶材价格上涨	日矿金属、霍尼韦尔、东曹、普莱克斯	江丰电子、有研新材、欧莱新材、阿石创、隆华科技	江丰电子全球市占率 25%+
电子级氢氟酸	2026 年 11 月 9 日我国 EL/UP/UPS/UPSS/UPSSS 级电子级氢氟酸价格分别为 8,050/8,500/9,500/10,500/11,800 元/吨，较年初分别 +27.07%/28.11%/26.67%/7.14%/7.27%。	原材料成本大幅上涨，G5 级电子级氢氟酸供需紧张	Stella Chemifa、森田化学、大金工业、关东化学、秀博瑞殷、霍尼韦尔、索尔维等	多氟多、中巨芯、滨化股份等	通用品类湿电子化学品（如电子级硫酸、双氧水、氢氟酸）国产化率 50%-80%，高端 G5 级国产化率 25%-30%
氦气	中东冲突爆发后，国产、进口管束氦气市场均价分别从 2 月底的 64.57 元/立方米和 82 元/立方米，最高攀升至 4 月中旬的 153 元/立方米和 162 元/立方米。当地时间 4 月 14 日，俄罗斯政府宣布对氦气实施临时出口管制，管制措施将持续至 2027 年底，直接引发氦气现货价格出现年内最大幅度上涨。国产管束氦气（最高价）和进口管束氦气（最高价）自 10 月起已步入下行区间，截至 10 月 27 日，分别报价 67.5 元/立方米、97.5 元/立方米。	2026 年全球氦气供应接连遭受较大冲击：卡塔尔氦气产能受损、俄罗斯氦气出口管制、美国氦气供应减量	美国和卡塔尔是全球主要的氦气供应国	广钢气体、金宏气体、华特气体、九丰能源	15%+

资料来源：证券时报网，爱集微，深圳市电子商会，上海证券报，电子工程世界，气体圈子，东方财富网，买化塑研究院，产业在线，氟化工产业圈，USGS，华尔街见闻，卓创资讯，九丰能源 2025 年年报，日本富士经济，江丰电子《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》，百川盈孚，江苏化工网，多氟多投资者关系活动记录，中银证券

电子材料国产替代持续推进

根据雅克科技 2025 年年报，近年来，依托国家政策支持和市场需求红利，我国半导体材料行业进入快速发展阶段，国产替代进程持续推进。国内材料企业产品技术水平和研发能力不断增强，从单一产品突破向产业链配套完善逐步过渡，整体产业竞争力稳步提升。随着全球半导体供应链本土化、多元化布局趋势加深，我国半导体材料行业有望迎来技术突破和市场扩容的双重发展机遇。此外，本轮下游高景气，叠加海外龙头扩产速度较慢、受到原材料供应波动等影响，我国半导体材料行业或迎来国产替代加速的关键窗口期。

图表 8. 国内部分企业部分晶圆制造材料业务进展（截至 2026 年中报）

企业	产品名称	业务进展
雅克科技	半导体前驱体材料	26H1 韩国先科实现营收 8.62 亿元、净利润 1.78 亿元（同比+8.74%），江苏先科实现营收 7.47 亿元（同比+34.69%）、净利润 0.77 亿元（同比+351.03%）。26H1 公司加大研发投入，已构建中国和韩国双研发部门，不断开发芯片先进制程薄膜沉积工艺和人工智能先进封装复杂芯片组所需的各种前驱体材料。国产化项目江苏先科 26H1 营收和营业利润同比大幅增长，目前已达到 high-k 前驱体有机配体完全自产能力，并向韩国子公司出口粗品前驱体。为满足海外晶圆厂对前驱体材料不断升级和扩大的需求，韩国子公司 UP CHEM 新建第三工厂，预计于 2026 年底全面投产，同时在 26H1 新购土地并开始第四工厂的规划。
	电子特气	国家电网及特高压直流工程的大规模建设将促进成都科美特六氟化硫绝缘气体的市场需求。同时，公司内蒙古科美特项目建设推进顺利，预计将于 26Q3 开始投入生产。12,000 吨六氟化硫及 3,000 吨四氟化碳电子特气新产能的建设，不仅能满足增量的市场需求扩大销售规模，而且充分利用内蒙古绿电资源禀赋，降低生产电费成本。
	湿电子化学品	公司拥有半导体和显示光刻胶的配套显影液、稀释剂和剥离液等湿电子化学品的南通和广州工厂，26H1 湿电子化学品客户端导入持续推进，已进入国内多家主流半导体晶圆厂及显示面板厂商供应链。依托半导体材料平台化布局，光刻胶配套试剂产品线生产和销售同比大幅增长。
安集科技	CMP 抛光液	26H1 公司抛光液收入 12.04 亿元（同比+29.47%），毛利率 55.58%（同比-2.52pct）。近三年公司化学机械抛光液全球市占率分别约 8%、11%、13%。26H1 公司铜及铜阻挡层抛光液产品在先进制程持续上量，多款产品在多个新客户端作为首选供应商实现量产销售，使用国产研磨颗粒的产品持续量产销售；在介电材料抛光液方面，部分用于先进制程的氮化硅抛光液已通过客户验证、实现销售，使用国产研磨颗粒的氧化物抛光液销售逐步上量；钨抛光液在存储芯片和逻辑芯片领域的成熟和先进工艺市场份额持续上升；基于氧化铈磨料的抛光液产品市占率持续扩大，使用自研自产的国产氧化铈磨料的多个抛光液产品在多个客户端量产应用，同时先进节点客制化产品在客户端验证顺利；金属栅极抛光液在数家客户实现量产并持续上量，应用于技术迭代的先进制程产品开发及验证顺利；在衬底抛光液方面，公司紧跟国内大硅片企业发展定制化开发抛光液产品。
	功能性湿电子化学品	26H1 公司功能性湿电子化学品收入 3.13 亿元（同比+51.03%），毛利率 55.99%（同比+6.98pct）。公司已覆盖刻蚀后清洗液、光刻胶剥离液、抛光后清洗液及刻蚀液等多种产品系列，广泛应用于逻辑电路、3DNAND、DRAM、CIS 等特色工艺及异质封装等领域。在刻蚀后清洗液方面，先进制程刻蚀后清洗液研发及产业化进展顺利、快速上量，并持续扩大海外市场；在抛光后清洗液方面，先进制程碱性铜抛光后清洗液进展顺利、快速上量，持续增加市场份额；刻蚀液验证进展顺利，实现小量量产。26H1 公司持续加强在 3D IC 领域布局，多款产品在国内客户成为首选，支持国内异质集成技术发展。
鼎龙股份	CMP 抛光垫	26H1 公司抛光垫收入 7.45 亿元（同比+56.83%），其中 26Q2 收入 3.69 亿元（同比+44.48%），6 月单月销量首次突破 5 万片。抛光硬垫方面，先进制程用抛光垫出货数量及占比持续增长，国内市场份额稳定提升，本土外资晶圆厂客户及海外市场开拓有序推进，已与多家外资晶圆厂客户达成初步合作意向并推进产品测试与导入。抛光软垫方面，潜江工厂软垫及缓冲垫持续稳定供应，积极拓展大硅片、第三代半导体 SiC、先进封装 TSV 等新领域市场，成功切入并获取订单。此外，公司开展下一代玻璃基板 CMP 抛光垫的研发和市场推广，成功获得板级封装领域重要客户订单。产能方面，公司建设武汉年产 40 万片大硅片抛光垫产能、潜江年产 30 万片玻璃基板 CMP 抛光垫及大尺寸抛光垫产能。
	CMP 抛光液、清洗液	26H1 公司抛光液、清洗液收入 1.93 亿元（同比+63.02%），其中 26Q2 收入 1.08 亿元（同比+70.69%，环比+27.33%），6 月单月销售额突破 4,000 万元。抛光液方面，26H1 公司大硅片精抛液产品实现批量交付，氧化铈抛光液产品在国内龙头存储芯片客户量产线导入成功、获得首张订单，TSV 抛光液通过国内先进封装龙头客户验证，铜阻挡层抛光液再获新客户批量订单，SiC 衬底抛光液取得国内客户批量采购订单；同时公司实现四大体系研磨粒子自研自产。清洗液方面，铜 CMP 后清洗液产品在国内多家客户实现增量销售，其他制程清洗液持续拓展市场，另有多款新产品在客户端持续开展验证。
	半导体光刻胶	公司已有 8 款高端晶圆光刻胶（浸没式 ArF 与 KrF 光刻胶各 4 款）取得多家国内主流晶圆厂客户批量订单，26H1 合计获取约 1,000 加仑订单。产能方面，公司潜江一期年产 30 吨 KrF/ArF 高端晶圆光刻胶产线稳定运行，二期年产 300 吨 KrF/ArF 高端晶圆光刻胶量产线已于 26Q1 末建成投产。

资料来源：各公司 2026 年中报，安集科技 2025 年年报，中银证券

续 图表 8. 国内部分企业部分晶圆制造材料业务进展（截至 2026 年中报）

企业	产品名称	业务进展
江丰电子	溅射靶材	26H1 公司高纯金属溅射靶材收入 16.71 亿元（同比+26.08%），毛利率 31.77%（同比-1.49pct）。公司在全球超高纯金属溅射靶材市占率不断提升，积极推进超高纯金属溅射靶材募投项目的建设投产，黄湖靶材智能工厂所涉厂房已按计划建成，同时韩国江丰靶材工厂主体工程已投入建设。
沪硅产业	硅片	300mm 方面，截至 26 年中报，公司上海、太原两地 300mm 半导体硅片合计产能达 100 万片/月，子公司上海新昇销量同比增幅超过 90%，至 2026 年底预计 300mm 半导体硅片产能将达到 120 万片/月。26H1 国内硅片市场逐步企稳回暖，预计相关红利将在 26H2 逐步释放。200mm 方面，公司 200mm 及以下抛光片、外延片合计产能超过 50 万片/月，200mm 及以下 SOI 硅片合计产能超 6.5 万片/月；Okmetic 在芬兰万塔的 200mm 半导体特色硅片扩产项目一期建设已基本完成，预计 26H2 产能将逐步释放。公司 300mmSOI 硅片正处于产品验证送样及小批量量产阶段，26H1 子公司新傲芯翼已建成产能约 30 万片/年的 300mm SOI 硅片试验线。26H1 子公司新硅聚合的单晶压电薄膜衬底材料产线完成既定建设计划，应用于滤波器的衬底实现量产并持续出货；完成光学级铌酸锂、钽酸锂薄膜衬底的研发并转入量产阶段；完成 200mm 单晶压电薄膜衬底的研发并实现批量交付，同时启动高频滤波器、高速光通信芯片新型衬底预研。
西安奕材	硅片	26H1 公司产线持续处于满稼动状态，在手订单充足。26H1 公司累计实现销量约 500 万片（同比+29.75%），实现营收 15.89 亿元（同比+22.00%），其中抛光片销售 5.21 亿元（同比+16.27%），外延片销售 4.88 亿元（同比+53.05%），测试片销售 5.77 亿元（同比+8.61%）。截至 26 年中报，公司已布局西安和武汉两个基地，其中西安基地第一工厂不断提升效能、第二工厂正在产能爬坡，位于武汉基地的第三工厂正处于厂房建设阶段，截至 26H1 公司产能合计达到 100 万片/月以上。26H1 公司出货量全球市占率约 7.7%，位居 12 英寸硅片领域国内第一、全球第六。公司预计 2026 年 12 月第二工厂 50 万片/月产能达产，届时将具备约 120 万片/月产能，有望位居国内第一、全球前五。第三工厂预计 2026 年 10 月实现首批设备搬入，27H1 实现首批产能投产，2030 年前实现达产，达产后总产能将提升至约 180 万片/月以上。
上海新阳	清洗液、刻蚀液、研磨液等系列产品	26H1 公司集成电路材料实现营收 9.82 亿元（同比+43.63%），毛利率 46.79%（同比+0.89pct）。公司干法刻蚀后清洗液产品已经实现 14nm 及以上技术节点全覆盖，26H1 干法刻蚀后清洗液产品销售规模不断扩大，销售额同比增长近 40%。公司原创开发的用于芯片制造的蚀刻液产品已实现四代技术产品的开发及迭代升级，26H1 蚀刻液销售额同比增长超 70%。公司化学机械研磨液产品持续优化，STI slurry、Poly slurry、W slurry、Oxide slurry 等系列产品在头部客户端测试验证顺利，其中先进制程 STI slurry、Poly slurry 产品已进入国内主流晶圆公司产线，26H1 研磨液产品销售额同比增长 140%。
	半导体光刻胶	公司已建成包括 I 线、KrF、ArF 干法、ArF 浸没式各类高端光刻胶完整的研发合成、配制生产、质量管控、分析测试平台，部分品类产品已实现产业化导入。26H1 公司形成批量稳定供货的光刻胶数量快速提升，整体销售规模同比增长 27%。
中船特气	电子特气	六氟化钨作为核心增长极，26H1 营收同比增长近 3 倍。境外高纯钨粉供给受限，叠加下游 AI 先进制程与高堆叠存储需求持续扩容，全球六氟化钨市场呈紧平衡态势。公司依托完整的上游原料自主配套优势，实现量价齐升，盈利质量显著改善。借此窗口期，公司六氟化钨产品境内实现新增产线全覆盖，境外获头部客户送样测试与产线全流程验证机会，长协签订工作有序推进，同时在美光、铠侠、英特尔、海力士等国际主流存储及逻辑芯片客户中市占率稳步提升。26H1 公司三氟化氮产品营收同比增长约 13%，境内方面新增多家大型面板企业的准入与批量供货，境外方面依托六氟化钨高景气带来的供应链替代窗口期，进一步提升海外头部客户供应量，并有序落地多家长期供货协议。三氟甲磺酸系列产品持续放量，26H1 实现营收约 2.12 亿元，同比增长超 40%。
广钢气体	电子大宗气体	26H1 公司电子大宗气体业务实现营收 10.56 亿元(同比+30.18%),毛利率 38.31%(同比+8.22pct),收入占比进一步提升至 79.20%;通用工业气体业务营收 2.17 亿元(同比-14.19%),毛利率 15.41%（同比+4.16pct）。公司 2011 年通过与外资合营合作进入电子大宗气体行业，2018 年中标国内半导体显示行业客户的现场制气项目，首次实现了内资气体公司在半导体显示行业供应超高纯电子大宗气体的突破。电子大宗气体现场制气项目供气周期通常长达 15 年，具备长周期、高稳定性的业务特征。公司电子大宗气体业务深度服务国内半导体与集成电路龙头客户群，截至 26H1 已累计获得 11 座 12 英寸晶圆厂客户认可。
清溢光电	掩膜版	26H1 公司平板显示掩膜版产品实现营收 5.28 亿元（同比+7.42%），半导体芯片掩膜版业务营收约 1.01 亿元（同比+0.95%）。公司 55nm Binary 工艺节点通过客户验证，目前正稳步推进 130nm－40nm 工艺节点 PSM 与 OPC 工艺掩膜版研发，并启动 28nm 节点掩膜版工艺开发规划，持续向高端制程突破。此外，公司已掌握电子束光刻、干法蚀刻等中高端掩膜版核心关键工艺，为后续产品升级与技术迭代筑牢基础。产能布局方面，佛山清溢微生产基地将在 2026 年底实现 PSM 技术掩膜版量产，助力公司抢占高端掩膜版市场份额。

资料来源：各公司 2026 年中报，安集科技 2025 年年报，中银证券

续 图表 8. 国内部分企业部分晶圆制造材料业务进展（截至 2026 年中报）

企业	产品名称	业务进展
路维光电	掩膜版	公司在显示领域已实现全世代覆盖（G2.5-G11）、全显示技术覆盖（LCD、AMOLED、LTPS、LTPO、Mini-LED、Micro-LED、硅基 OLED、FMM 用掩膜版等）；在半导体领域则全面布局先进封装及成熟制程用掩膜版市场，广泛服务于晶圆制造企业、IC 设计公司及封装测试厂商；通过投资路芯半导体将半导体掩膜版制程拓展至 14nm。
彤程新材	半导体光刻胶	26H1 公司电子化学品业务实现营收 6.93 亿元（同比+56.89%），占总营收比重提升至 32.44%；实现利润 1.06 亿元（同比+近 180%）；其中光刻胶及配套试剂实现营收 5.2 亿元。26H1 公司半导体光刻胶及配套试剂实现营收 2.86 亿元，同比增长近 50%；ArF 及 BARC 产品同比增幅接近 300%，多款产品包含 3 款浸没式光刻胶，在客户端实现稳定量产供应；KrF 光刻胶在售产品超过 60 款，国内本土市场占有率已超过 10%；G/I 线光刻胶在售产品超过 100 款，国内本土市场占有率超过 35%。多款光刻胶产品搭载公司自研树脂。公司已实现对国内绝大部分 12 英寸产线的稳定供货，12 英寸产品收入占比突破 50%。26H1 公司已有超 20 款新产品得到客户正式订单。
	CMP 抛光垫	26H1 公司抛光垫业务销售总额超 2,000 万元。先进抛光垫硬垫产品系列自 2025 年末起陆续送样头部客户开展验证，目前该高端产品系列已完成客户验证，正逐步导入量产。公司抛光垫软垫生产线已建成落地，截至 26 年中报，软垫样品已送样国内多家主流 12 英寸晶圆厂，进入客户验证导入环节。伴随硬垫产品量产导入稳步推进、软垫客户端验证持续深化，公司预计下半年抛光垫业务将进入快速上量阶段。
兴福电子	通用湿电子化学品	26H1 公司集成电路领域销售收入占主营业务收入比例达 87.82%，集成电路领域销售收入中通用湿电子化学品销量 8.90 万吨（同比+24.65%），收入 6.09 亿元（同比+34.13%）。电子级硫酸小粒径颗粒物指标进一步优化，顺利通过新加坡镁光、鹏芯微等高端客户验证，已启动批量供货，多家国内头部晶圆厂测试稳步推进；电子级双氧水金属离子含量、阴离子含量实现稳定控制，产品纯度指标持续优化，顺利通过鹏芯微等高端客户验证，并实现稳定销量；电子级磷酸持续开展纯化工艺升级，核心品质稳定性大幅提升。同时，电子级氨水、电子级氨气、电子级异丙醇等产品及配套化学品纯化技术持续突破，客户验证与批量供货同步落地。
	功能湿电子化学品	26H1 公司功能湿电子化学品销量 0.72 万吨（同比+75.61%），收入 1.46 亿元（同比+56.73%）。高选择比磷酸、先进金属蚀刻液积极推进国内头部存储厂商测试验证，计划年内供应；硅锗系列高性能蚀刻液整体性能达到行业先进水平，多款新品实现批量销售。多款 BOE 蚀刻液产品完成客户端验证与供应，同时稳步推进高端电子清洗剂配方自主开发及头部客户送样验证，先进制程专用清洗剂验证效果符合预期。玻璃基化镀镍金药水已实现客户稳定供货，硅基化镀镍钯金药水完成工艺优化并实现小批量销售。

资料来源：各公司 2026 年中报，安集科技 2025 年年报，中银证券

图表 9. 国内部分企业先进封装材料项目进展（截至 2026 年中报）

企业	产品名称	技术进展
鼎龙股份	半导体封装 PI、临时键合胶	26H1 公司半导体先进封装材料产品处于销售起量阶段，新产品的验证导入及市场推广持续推进。半导体封装 PI 方面，公司已布局 8 款产品，目前共有 3 款产品取得多家客户的订单，在售型号数量及覆盖客户数量进一步增加，推动订单增长持续加速。临时键合胶方面，公司在已有客户持续稳定规模出货中。
德邦科技	芯片级底部填充胶（Underfill）、Lid 框粘接材料（AD 胶）、芯片级导热界面材料（TIM1）、固晶胶膜（DAF 膜）等	26H1 公司集成电路封装材料实现营收 1.79 亿元（同比+58.45%），毛利率 38.91%（同比-3.98pct）。公司晶圆 UV 膜、固晶胶、TIM1.5/TIM2 高端导热界面材料等产品已在国内主流封测厂商实现稳定批量供货，成熟品类国产化配套优势持续夯实；DAF/CDAF 膜、底部填充胶（Underfill）、Lid 框胶已实现小批量交付，芯片级导热材料（TIM1）已顺利通过国内某重要封测客户全套可靠性验证，芯片级先进封装材料商业化落地进程持续提速。
飞凯材料	EMC 环氧塑封料、键合胶、先进封装光刻胶等	26H1 公司半导体材料实现营收 3.58 亿元（同比+8.17%）。面向先进封装技术前沿，公司围绕临时键合工艺推出键合胶与清洗液全配套解决方案，兼容热力、机械及激光等多种解键合方式。公司在蚀刻液、去胶液、电镀液等湿制程电子化学品领域的先期卡位，已使相关产品成为多家头部客户的标准制程材料，并成功延伸应用于 2.5D/3D 及 HBM 等高端封装场景。近年推出的 Ultra Low Alpha Microball（ULA 微球）、临时键合全套方案、先进封装光刻胶及 EMC 环氧塑封料等新品，均可适配 2.5D/3D 封装及 HBM 封装需求。公司控股子公司昆山兴凯聚焦半导体封装材料国产化与高端应用，是中高端元器件及 IC 封装所需的封装材料领域主要供货商之一。
强力新材	光敏性聚酰亚胺（PSPI）、半导体先进封装用电镀材料	公司积极研发推进新产品，例如应用于半导体先进封装领域的光敏性聚酰亚胺（PSPI）及电镀铜、镍、锡银等电镀液产品。公司的光敏性聚酰亚胺（PSPI）产品包括 350℃高温固化、250℃低温固化及 180℃超低温固化三种类型。电镀铜、镍、锡银等电镀液产品，可覆盖 RDL、Pillar、μBump、TSV、TIV、大马士革等工艺。26H1 公司高温 PSPI 产品收到某贸易商百公斤级订单，该订单的产品应用于前制程（应力缓冲层 Buffer coat），订单金额不足两百万元人民币。截至 26 年中报，该订单已交付过半。26H1 公司高温 PSPI 和低温 PSPI 产品，陆续收到国内某客户订单，订单总数量不足一百公斤，订单产品应用于先进封装领域中的 RDL 层。部分电镀液产品在客户端处于小批量产品验证阶段。
天承科技	半导体先进封装专用化学品	公司围绕集成电路、2.5D/3D 先进封装、扇出型封装、玻璃基板等领域需求积极研发，目前公司已完成大马士革电镀铜、硅通孔（TSV）电镀铜、再布线层（RDL）电镀铜、凸点（bumping）电镀铜/镍/锡银和玻璃基板通孔 TGV 金属化等工艺所需电镀液产品的研发和技术储备。
上海新阳	电镀液及添加剂	公司电镀系列材料已广泛应用于先进封装工艺制程，为客户提供良好的技术保证。公司电镀系列产品的市场影响力从传统封装、晶圆制造延伸至先进存储领域。26H1 公司电镀液及添加剂系列产品销售额同比增长超 30%。
安集科技	CMP 抛光液、清洗液 电镀液及添加剂	26H1 公司持续加强在先进封装用抛光液的布局，用于 TSV、TGV 抛光液、混合键合抛光液和聚合物抛光液进展顺利，在国内客户均作为首选供应商帮助客户打通技术路线，并持续为客户的新工艺开发产品，助力国内先进封装技术的发展，销售持续上量。26H1 公司集成电路大马士革电镀液及添加剂进入量产阶段，实现销售；硅通孔电镀液及添加剂进入量产阶段，实现销售；先进封装锡银电镀液及添加剂等产品开发及验证按计划进行。
艾森股份	电镀液及添加剂 先进封装光刻胶、PSPI	公司高纯硫酸铜基液已实现先进封装头部客户的稳定供应，另有多项前沿产品已进入商业化关键阶段：电镀锡银添加剂（包括超低 α 粒子的锡浓缩液、锡阳极）小批量稳定量产，并在多家头部客户同步验证中；电镀铜添加剂处于关键批次稳定性验证阶段；TSV 电镀铜添加剂在客户端测试验证中。 公司涵盖可应用于 GHI-line、I-line 光源的光刻胶产品，包括正性、化学放大型光刻胶及负性光刻胶，不同产品膜厚兼容 7-300μm，在 Bumping、RDL、TSV、fine pitch RDL、μBumping、μPad、Mega-Bumping 等先进封装核心工艺环节，正稳步构建光刻胶全场景产业化覆盖能力。同时公司加速推进用于 Bumping、WLCSP、2.5D/3D 封装 PSPI 的验证与量产，产品包括高温固化、低温固化、超低温固化系列，其中低温 PSPI 在客户端小量产中，具备低应力、高可靠性及高分辨率的 PSPI 产品在客户端验证中。公司目标成为国内先进封装光刻胶和 PSPI 领域的主力供应商。

资料来源：各公司 2026 年中报，中银证券

电子材料行业 2026 年前三季度业绩综述

为复盘 2026 年前三季度电子材料行业整体业绩表现，我们选取申万三级子行业 SW 半导体材料（30 家标的）、SW 电子化学品（37 家标的）以及彤程新材、联瑞新材合计 69 家标的，组成电子材料行业标的库。我们对该标的库内的区间涨跌幅、总市值、营业总收入、归母净利润、毛利率、净利率、研发费用率等指标进行了统计分析。注：因部分材料公司包含其他业务（如传统化工产业占比较高），部分指标分析可能有所偏差。

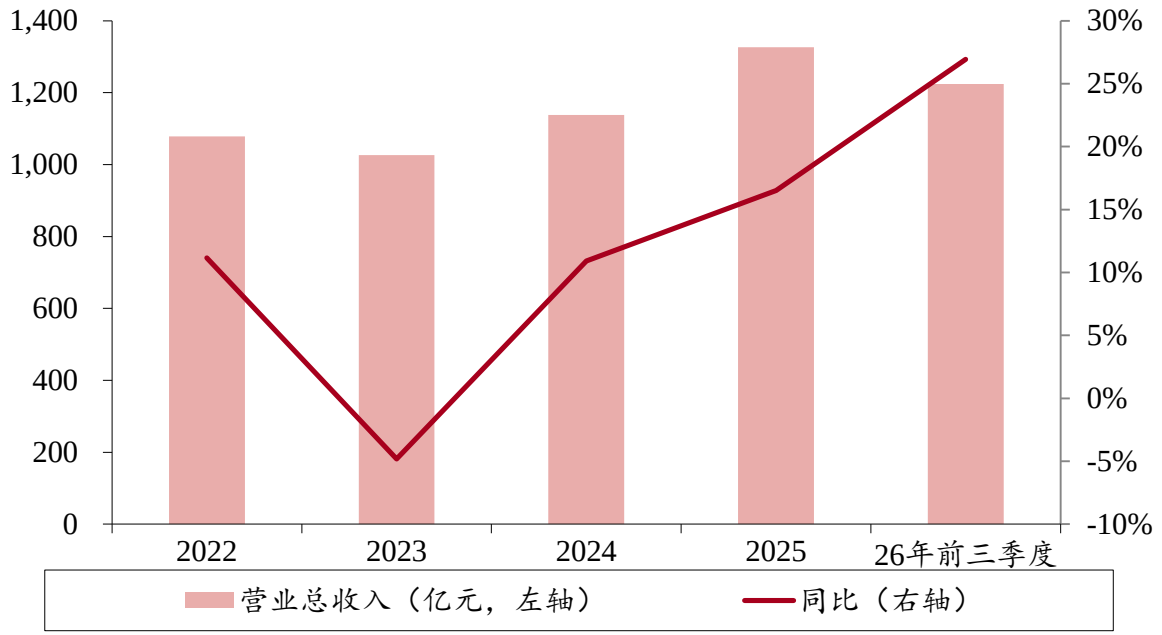
此外，截至 2026 年 11 月 6 日收盘，69 家样本中总市值 300 亿元以上标的共 13 家（9 月 30 日为 24 家，板块回调后数量减少）。

营业总收入：行业收入普遍增长

2026 年前三季度 69 家标的（以下用“全行业”表示）营收合计 1,224.02 亿元（同比+26.94%），营收同比增长的有 63 家，占比 91.3%，其中增速超 30%的有 27 家、超 50%的有 9 家。13 家市值 300 亿元以上标的（以下用“龙头企业”表示）营收 465.09 亿元（同比+27.05%），占样本的 38.00%；其余 56 家合计 758.93 亿元，同比增长 26.87%。两组收入增速接近，说明行业收入增长具有普遍性；但从增量看，13 家龙头企业贡献 99.03 亿元，占全部收入增量的 38.12%，头部集中的特征仍然明显。

单季度来看，26Q3 全行业营收为 440.80 亿元（同比+24.31%，环比+5.03%）。13 家龙头企业营收 162.79 亿元（同比+25.20%，环比-0.40%），环比增速居前标的为西安奕材（同比+68.50%，环比+22.68%）、江丰电子（同比+44.42%，环比+20.68%）、安集科技（同比+38.39%，环比+15.66%），环比下降标的为雅克科技（同比+1.57%，环比-13.09%）、有研新材（同比-13.86%，环比-28.03%）。

图表 10. 2022-2026 年前三季度电子材料行业营业总收入及同比



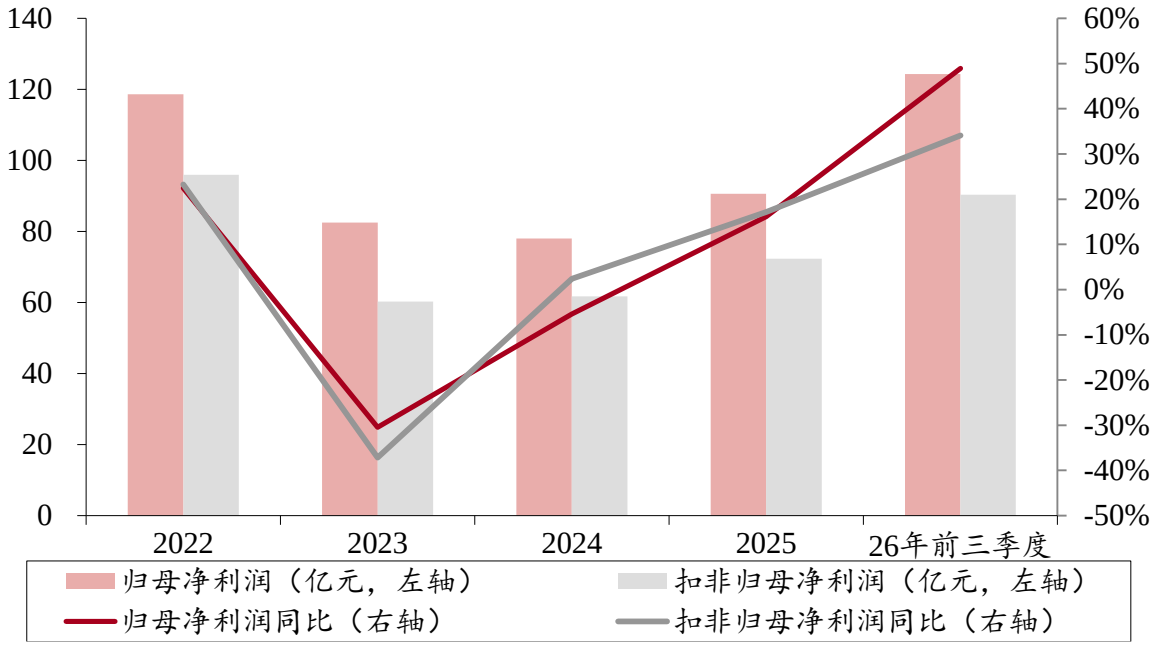
资料来源：同花顺 iFinD，中银证券

归母净利润/扣非归母净利润：26Q3 利润端大幅提升，部分利润受非经常性项目抬升

2026 年前三季度全行业归母净利润合计 124.37 亿元（同比+48.96%），增速高于收入 22.02pct。归母净利润同比增长 47 家（其中扭亏 5 家、减亏 1 家），其中增速超过 100%的有 16 家；同比下降 22 家（其中转亏 3 家，连续亏损且亏损扩大 2 家）。13 家龙头企业归母净利润 60.87 亿元（同比+105.11%），占样本的 48.94%；其余 56 家合计 63.50 亿元，同比增长 18.00%。13 家龙头企业贡献归母净利润增量 31.19 亿元，占全部增量的 76.31%，集中度高于收入。其中中船特气、安集科技、江丰电子、有研硅、广钢气体五家归母净利润合计增加 20.09 亿元，占全行业增量的 49.15%。从扣非归母净利润口径看，2026 年前三季度全行业扣非归母净利润 90.34 亿元（同比+34.10%）。

单季度来看，26Q3 全行业归母净利润 59.28 亿元（同比+90.89%，环比+50.98%）。13 家龙头企业归母净利润 35.67 亿元(同比+261.22%，环比+118.64%)，环比增速前三为西安奕材(同比+302.55%，环比+436.53%)、有研硅(同比+372.25%，环比+177.04%)、安集科技(同比+261.87%，环比+159.81%)，环比增量主要来自非经常性损益；扣非归母净利润环比增速前三为江丰电子（同比+94.23%，环比+182.11%）、安集科技（同比+66.85%，环比+31.67%）、中船特气（同比+408.31%，环比+30.71%）。

图表 11. 2022-2026 年前三季度电子材料行业归母净利润、扣非归母净利润及同比



资料来源：同花顺 iFinD，中银证券

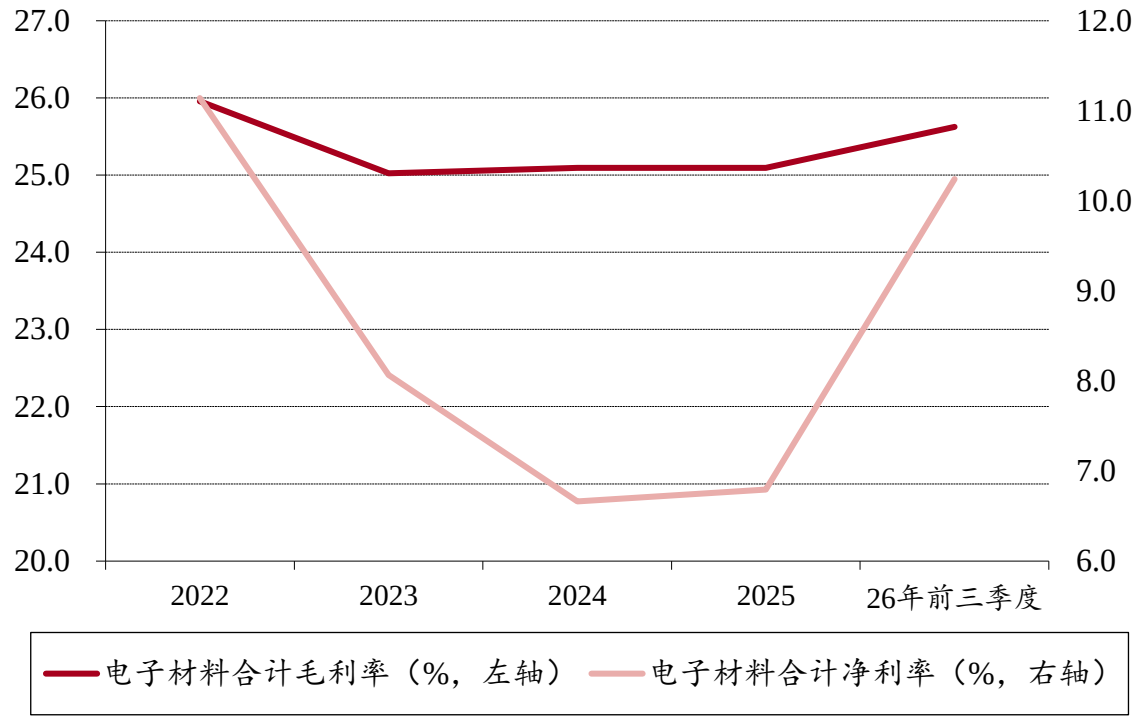
毛利率与净利率：26Q3 同环比均提升

2026 年前三季度全行业综合毛利率 25.63%（同比-0.23pct），净利率 10.24%（同比+1.43pct），毛利率与净利率反向，差额来自非经常性损益与费用率下降。公司分布上，毛利率同比提升 29 家、下降 40 家，下降家数更多而加权毛利率仅降 0.23 个百分点，说明下滑集中在收入权重较小的公司。13 家龙头企业毛利率 25.80%（同比+1.07pct），净利率 13.08%（同比+5.07pct），表明龙头企业毛利率较平稳、净利率提升较快。

单季度来看，26Q3 全行业综合毛利率 26.63%（同比+0.42pct，环比+1.00pct），净利率 13.47%（同比+4.37pct，环比+3.96pct）。13 家龙头企业综合毛利率 28.03%（同比+3.36pct，环比+2.56pct），净利率 21.79%（同比+14.08pct，环比+11.64pct）。

我们认为头部材料企业毛利率较平稳、净利率提升较快主要来自以下方面：硅片、电子特气、靶材等品类提价逐步落地反映在财务报表；产能利用率提升摊薄固定成本；产品结构向先进制程、先进封装等高价值品类倾斜。

图表 12. 2022-2026 年前三季度电子材料行业毛利率、净利率

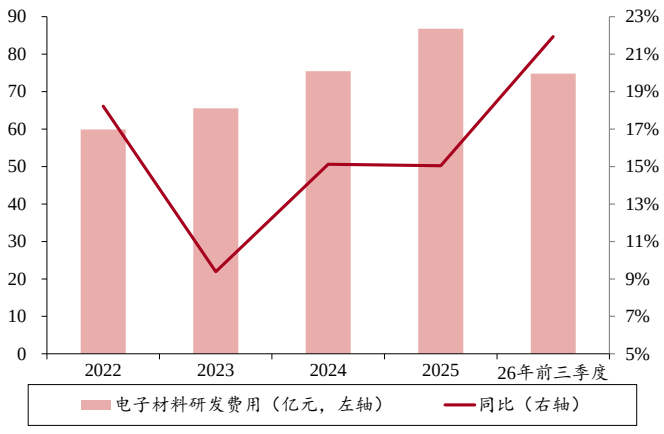


资料来源：同花顺 iFinD，中银证券

研发费用：投入持续增加，费用率受收入摊薄

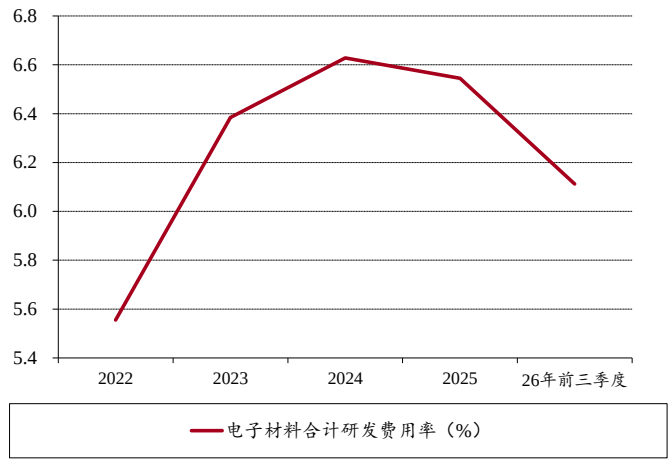
2026 年前三季度全行业研发费用合计 74.81 亿元（同比+21.93%），低于收入增速 5.01pct；研发费用率 6.11%（同比-0.25pct）。13 家龙头企业研发费用 29.46 亿元（同比+15.54%），研发费用率 6.34%（同比-0.63pct），其中前三位为安集科技（15.54%）、鼎龙股份（15.22%）、沪硅产业（10.84%）。单季度看，26Q3 全行业研发费用 26.76 亿元（同比+17.90%，环比+2.23%），研发费用率 6.07%（同比-0.33pct，环比-0.17pct）。我们认为，半导体材料研发周期长、投入强度高，研发费用率同环比下降主要来自收入高增速摊薄而非研发费用收缩。

图表 13. 2022-2026 年前三季度电子材料行业研发费用及同比



资料来源：同花顺 iFinD，中银证券

图表 14. 2022-2026 年前三季度电子材料行业研发费用率

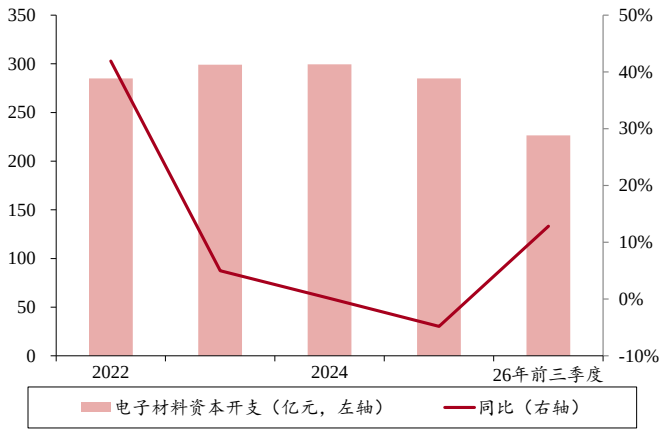


资料来源：同花顺 iFinD，中银证券

资本开支：扩张节奏放缓，硅片龙头投入强度较大

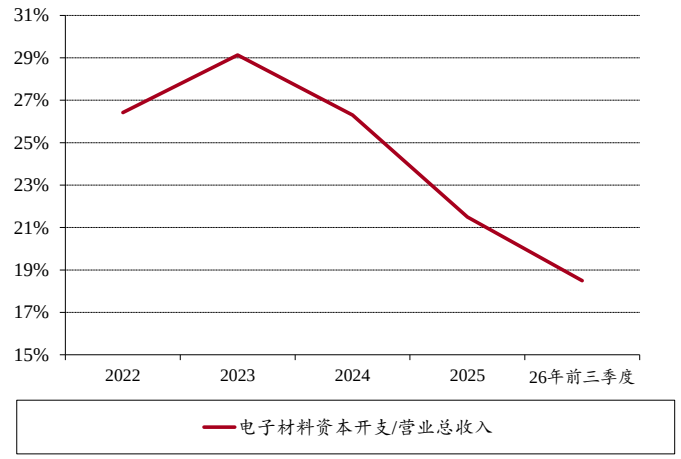
2026 年前三季度全行业资本开支合计 226.42 亿元（同比+12.82%），资本开支占营业收入的比重由 2025 年前三季度的 20.81%降至 18.50%。13 家龙头企业资本开支合计 118.01 亿元（同比+16.69%），占样本的 52.13%，投入强度 25.37%（2025 年前三季度 27.63%）。公司分布上，2026 年前三季度资本开支同比增长 45 家、下降 24 家，其中沪硅产业（39.03 亿元）、西安奕材（20.82 亿元）两家占 26.44%，投入强度分别达 107.34%、78.54%。单季度看，26Q3 资本开支 90.75 亿元（同比+27.31%，环比+20.08%），占前三季度支出的 40.08%，为年内高点。

图表 15. 2022-2026 年前三季度电子材料行业资本开支及同比



资料来源：同花顺 iFinD，中银证券

图表 16. 2022-2026 年前三季度电子材料行业资本开支/营业总收入



资料来源：同花顺 iFinD，中银证券

市值 300 亿元以上标的：利润增速显著

如前文所述，截至 2026 年 11 月 6 日收盘，69 家样本中总市值 300 亿元以上龙头企业共 13 家，合计总市值 6,196.98 亿元，占 69 家合计市值 12,876.30 亿元的 48.13%。2026 年前三季度 13 家龙头企业营收 465.09 亿元（同比+27.05%，增速较全行业高 0.11pct）、归母净利润 60.87 亿元（同比+105.11%，增速较全行业高 56.15pct）、扣非归母净利润 33.84 亿元（同比+47.55%，增速较全行业高 13.46pct），分别占全行业的 38.00%、48.94%、37.46%。

图表 17. 市值 300 亿元以上部分标的 2026 年前三季度业绩（总市值截至 2026.11.6）

公司	细分赛道	市值（亿元）	营收（亿元）	营收同比（%）	归母净利润（亿元）	归母净利润同比（%）	扣非归母净利润（亿元）	扣非归母净利润同比（%）	毛利率（%）	净利率（%）
中船特气	电子特气(六氟化钨、三氟化氮等)	762.35	31.23	94.34	6.61	169.26	6.34	200.68	34.28	21.16
沪硅产业	半导体硅片	681.83	36.37	37.69	(7.28)	增亏	(13.32)	增亏	(6.37)	(20.03)
西安奕材	半导体硅片	610.11	26.51	37.16	1.51	扭亏	(4.73)	减亏	5.13	5.71
鼎龙股份	CMP 抛光材料、高端晶圆光刻胶	585.86	29.13	7.97	8.52	64.00	7.91	60.01	60.02	29.24
江丰电子	溅射靶材、半导体零部件	539.44	44.65	35.67	8.11	102.38	4.33	47.95	30.87	18.16
安集科技	CMP 抛光液、功能性湿电子化学品	469.73	24.54	35.45	13.74	125.83	7.27	35.32	56.05	55.97
有研硅	半导体硅材料	423.85	10.62	42.20	3.62	131.74	1.41	42.65	32.99	34.08
雅克科技	半导体前驱体	407.73	67.21	3.93	8.34	4.74	8.18	2.57	30.58	12.41
国瓷材料	电子陶瓷材料	384.76	40.79	24.21	5.45	11.43	5.35	12.02	37.34	13.37
广钢气体	电子大宗气体	342.65	21.19	23.10	4.13	105.81	3.94	124.27	36.29	19.49
有研新材	高纯靶材、稀有金属材料	324.15	84.62	24.98	2.63	7.31	2.17	33.20	8.10	3.11
彤程新材	半导体光刻胶、CMP 抛光垫	313.26	32.64	29.37	5.22	5.66	4.90	4.99	23.03	15.99

资料来源：同花顺 iFinD，中银证券

注：按总市值降序排序，总市值截至 2026 年 11 月 6 日收盘

电子材料行业 26Q4 及未来展望

需求端：AI 与存储高景气有望延续，先进技术迭代促进材料需求持续扩大。从下游需求看，全球半导体市场有望继续维持高增速，对晶圆制造材料与封装材料的消耗量有望持续提升。中长期来看，先进技术迭代促进材料需求持续扩大，先进制程与先进封装共同推动材料用量与品类扩容。例如，根据雅克科技 2026 年半年度报告，半导体制程节点迭代下晶体管走向三维架构，晶圆高深宽比结构数量持续增加，ALD 工序数量持续上涨——存储领域 2D NAND 向多层 3D NAND 升级使 ALD 工艺步骤近乎翻倍，逻辑领域 7nm 及以下 GAA 节点 ALD 工序进一步成倍提升；同时先进封装、三维集成推动 ALD 从前道晶圆制造延伸至后道，在 TSV、HBM、混合键合等工艺场景大规模落地应用。根据 SEMI 数据，2025 年全球封装材料市场销售额同比增长 9.3%，增速高于晶圆制造材料的 5.4%，先进封装相关材料正成为增长最快的方向之一。根据联瑞新材 2026 年半年度报告，异构集成先进封装（Chiplet、HBM 等）、新一代高频高速覆铜板（M8、M9、M10 等）等下游应用持续拉动纳米级球形二氧化硅、液相法球形二氧化硅、Low α 微米/亚微米球形二氧化硅等高端粉体需求。根据鼎龙股份 2026 年半年度报告，公司开展下一代玻璃基板 CMP 抛光垫的研发和市场推广，成功获得板级封装领域重要客户订单，实现在先进封装领域的新突破。

价格端：部分材料进入涨价周期，盈利弹性有望逐渐释放。本轮半导体材料涨价已覆盖硅片、电子特气、靶材、湿电子化学品等多个核心品类。从涨价节奏看，虽然部分材料提价已有一定时间，但材料企业多与下游客户签订季度、半年度、年度长协，需结合细分产品规格、应用领域及客户合作情况有序开展价格优化与业务磋商，我们预计材料涨价带来的相关效益有望在 2026 年下半年及以后逐渐体现。从盈利弹性来看，电子特气、溅射靶材等高壁垒品类龙头（如中船特气、江丰电子等）盈利弹性较大，此外大硅片赛道（如沪硅产业、西安奕材等）企业的毛利率有望在 2026 年下半年及以后环比修复。

市占率：材料国产化加速推进，平台化、国际化布局持续深化。本轮下游高景气叠加部分海外供应波动，我国半导体材料行业或迎来国产替代加速的关键窗口期。根据有研新材 2026 年半年度报告，国内头部 12 英寸晶圆厂、存储厂建立本土材料供应商白名单机制，优先推进铜、钴、钽、钨、钌等高纯靶材国产化切换；钨、镓、锗、高纯钽相关两用物项出口管制细则落地执行，上游超高纯金属原料自主供给优势进一步巩固，倒逼海外晶圆厂主动加大国产靶材导入比例。根据沪硅产业 2026 年半年度报告，公司 300mm 半导体硅片已在逻辑工艺与存储工艺实现产品全覆盖，26H1 太原工厂新增客户 22 家、新增量产产品 42 款；国内硅片市场逐步企稳回暖，预计相关红利将在 26H2 逐步释放。根据中船特气 2026 年半年度报告，公司六氟化钨产品境内实现新增产线全覆盖，境外获得头部客户送样测试与产线全流程验证机会，国产特气加速导入全球供应链。此外，电子材料企业向平台化产业链配套转型，并持续深化国际化布局。根据鼎龙股份 2026 年半年度报告，公司以半导体材料为核心，产品覆盖集成电路制造、先进封装、半导体显示等领域，CMP 抛光垫、抛光液、清洗液及高端晶圆光刻胶协同发展，并拓展大硅片、SiC、先进封装用 TSV 等新应用场景；根据安集科技 2026 年半年度报告，公司围绕化学机械抛光液、功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂三大产品平台及上游关键原材料持续布局，提升一站式服务能力；根据雅克科技 2026 年半年度报告，公司电子材料产品线覆盖半导体前驱体、光刻胶及配套试剂、电子粉体材料、特种气体等，已构建中国和韩国双研发部门，韩国子公司 UP CHEM 第三工厂预计 2026 年底全面投产、第四工厂已启动规划。

除内生研发外，外延并购亦成为企业快速切入的路径。根据翰博高新公告，公司参股公司芯东进以 1.421 亿美元收购东进世美肯（上海）70%股权，获其境内 9 家湿电子化学品公司 100%股权及 24 项专利，2026 年 11 月公司再以 1.22 亿元增持至 73.18%并纳入合并报表，通过收购资产直接快速获取湿电子化学品行业的成熟技术、规模化产能、稳定客户资源及本土化布局优势。根据聚和材料公告，公司已于 2026 年 3 月完成对 SK Enpulse 空白掩膜版业务的收购，SKE 公司是韩国半导体材料零部件设备整体解决方案供应商，旗下 Blank Mask 事业部主要生产用于 DUV-ArF 和 DUV-KrF 光刻技术节点的空白掩膜基板，产品已通过多家半导体晶圆厂自有产线配套验证及第三方独立掩膜版客户验证，并实现量产销售，业务覆盖韩国、中国大陆及中国台湾等国家和地区。

综合来看，受下游高景气延续以及半导体材料涨价驱动，叠加产能陆续释放、国产化持续推进，我们预计材料企业收入将维持较快增长，其中先进制程及先进封装相关材料以及国产替代兑现节奏较快的品类有望延续领跑态势。

投资建议

基于下游行业快速发展、先进技术不断迭代以及国产替代大背景，我们认为电子材料领域有望持续迎来发展良机。

1、受益于下游需求增长以及技术不断进步，全球半导体材料市场规模持续扩大，先进材料需求快速提升。在多种关键半导体材料方面，我国企业稳健布局产能与技术研发，竞争力与产销规模有望持续提升。

2、部分半导体材料及原料受益于涨价，下游高景气叠加海外龙头扩产速度较慢、受到原材料供应波动等影响，我国半导体材料行业或迎来国产替代加速的关键窗口期。

推荐：**安集科技、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技、彤程新材、沪硅产业、德邦科技、莱特光电、瑞联新材**；建议关注：**国瓷材料、华特气体、联瑞新材、中船特气、中巨芯、西安奕材、广钢气体、昊华科技、翰博高新等**。

风险提示

技术升级迭代的风险。半导体材料行业目前正处于高速发展阶段，材料厂商需要具备持续的研发创新能力及客户合作基础，才能跟上技术迭代需求。若相关材料企业未来不能准确把握客户的需求变化，技术升级迭代进度和成果未达预期，将对公司经营业绩产生影响。

下游需求复苏不及预期的风险。若宏观经济以及消费回暖情况不及预期，将对位于产业链上游相关材料端企业的生产经营产生不利影响。

全球经济周期性波动、国际贸易摩擦及不可抗力的风险。若国际贸易摩擦、地缘政治矛盾加剧，可能对半导体产业链带来一定不利影响，导致下游客户需求或者订单量产生不利波动，进而影响公司业绩。此外，如果发生自然灾害、战争或其他突发性不可抗力事件，可能对上游原材料供应、下游市场及相关材料公司经营业绩造成影响。

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

买　　入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上；

增　　持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%；

中　　性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；

减　　持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上；

未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数；

中　　性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平；

弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数；

未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司
中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

相关关联机构：

中银国际证券有限公司
香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话:(852) 3988 6333
致电香港免费电话:
中国网通 10 省市客户请拨打：10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打：10800 1521065
新加坡客户请拨打：800 852 3392
传真:(852) 2147 9513

中银国际控股有限公司北京代表处
中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编:100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

中银国际(英国)有限公司
2/F, 1 Lothbury
London EC2R 7DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

中银国际(新加坡)有限公司
注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦三十楼(049908)
电话: (65) 6671 8686
传真: (65) 6671 8687